景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）
2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 07 月 01 日起至 2026 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）
场内简称	全球芯片 LOF
基金主代码	501225
基金运作方式	上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日	2023 年 3 月 30 日
报告期末基金份额总额	305,321,538.82 份
投资目标	本基金在严格控制组合风险与保持资产流动性的基础上，主要投资于全球范围内半导体芯片产业主题相关的公募基金的基金份额和相关上市公司，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	1、国家与地区配置策略 本基金在全球范围内进行投资，采用“自上而下”方法进行国家及地区的资产配置。本基金将综合运用定性和定量分析方法，分析各个国家及地区的人口结构、宏观经济形势、经济政策等，以及各个市场估值水平，并结合各市场的风险水平，动态地确定基金资产在各个国家及地区的资产配置。 2、主题界定

	本基金采取主题投资策略，本基金的半导体芯片产业主题的界定如下：（1）对于股票型基金，主要指境内外跟踪半导体或芯片产业相关指数的 ETF 或者指数型证券投资基金；（2）对于股票，主要投资于境内外半导体或芯片产业相关指数的成份股及其备选成份股。 3、基金投资策略 本基金在全球范围内精选跟踪全球半导体芯片产业的主题基金（含 ETF 和其它指数型证券投资基金），通过定量分析和定性分析相结合的方式筛选标的基金。 4、股票投资策略 本基金将挑选出境内外半导体或芯片产业具有代表性的相关指数，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取相关指数成份股和备选成份股中流动性较好的股票，构造与本基金主题投资相匹配和风险收益特征相似的股票组合，进行被动式投资。 5、存托凭证投资策略 本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资目标和上述股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，通过定性和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 6、金融衍生品投资策略 本基金将按照风险管理的原则，谨慎参与各类金融衍生品投资，将适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生品，如期货、期权、权证、远期合约、掉期、结构性投资产品以及其他衍生工具。 7、债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。 8、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的

	证券的久期与收益率的影响。	
业绩比较基准	费城半导体指数收益率 (PHLX Semiconductor Sector Index)*70%+中证芯片产业指数收益率*20%+人民币活期存款基准利率*10%	
风险收益特征	本基金投资于 ETF 的比例不低于本基金资产的 80%，投资于本基金界定的半导体芯片产业主题的权益类资产（包括股票、股票型基金）的比例不低于本基金非现金资产部分的 80%，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型证券投资基金、债券型证券投资基金及货币市场基金。	
基金管理人	景顺长城基金管理有限公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	景顺长城全球半导体芯片股票 A（QDII-LOF）	景顺长城全球半导体芯片股票 C（QDII-LOF）
下属分级基金的交易代码	501225	016668
报告期末下属分级基金的份额总额	233,206,936.03 份	72,114,602.79 份
境外资产托管人	英文名称：HSBC	
	中文名称：香港上海汇丰银行有限公司	

注：本基金 A 类份额含 A 类人民币份额（份额代码：501225）及 A 类美元现汇份额（份额代码：016667），交易代码仅列示 A 类人民币份额代码；本基金 C 类份额含 C 类人民币份额（份额代码：016668），交易代码仅列示 C 类人民币份额代码。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日）	
	景顺长城全球半导体芯片股票 A（QDII-LOF）	景顺长城全球半导体芯片股票 C（QDII-LOF）
1.本期已实现收益	56,376,497.10	17,809,308.57
2.本期利润	-160,525,494.85	-55,552,855.89
3.加权平均基金份额本期利润	-0.6821	-0.7325

4.期末基金资产净值	724,494,323.70	220,797,345.05
5.期末基金份额净值	3.1066	3.0617

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城全球半导体芯片股票 A（QDII-LOF）

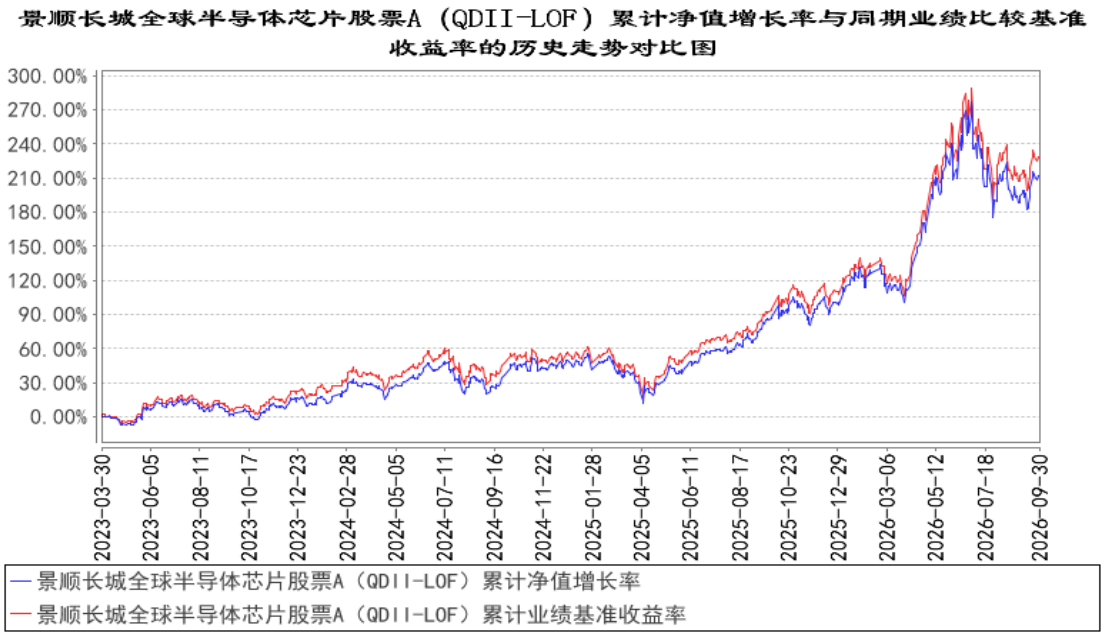
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-17.73%	2.67%	-16.27%	2.51%	-1.46%	0.16%
过去六个月	49.73%	2.83%	51.16%	2.75%	-1.43%	0.08%
过去一年	65.07%	2.43%	67.15%	2.41%	-2.08%	0.02%
过去三年	198.65%	2.01%	201.93%	2.04%	-3.28%	-0.03%
自基金合同生效起至今	210.66%	1.93%	226.12%	1.95%	-15.46%	-0.02%

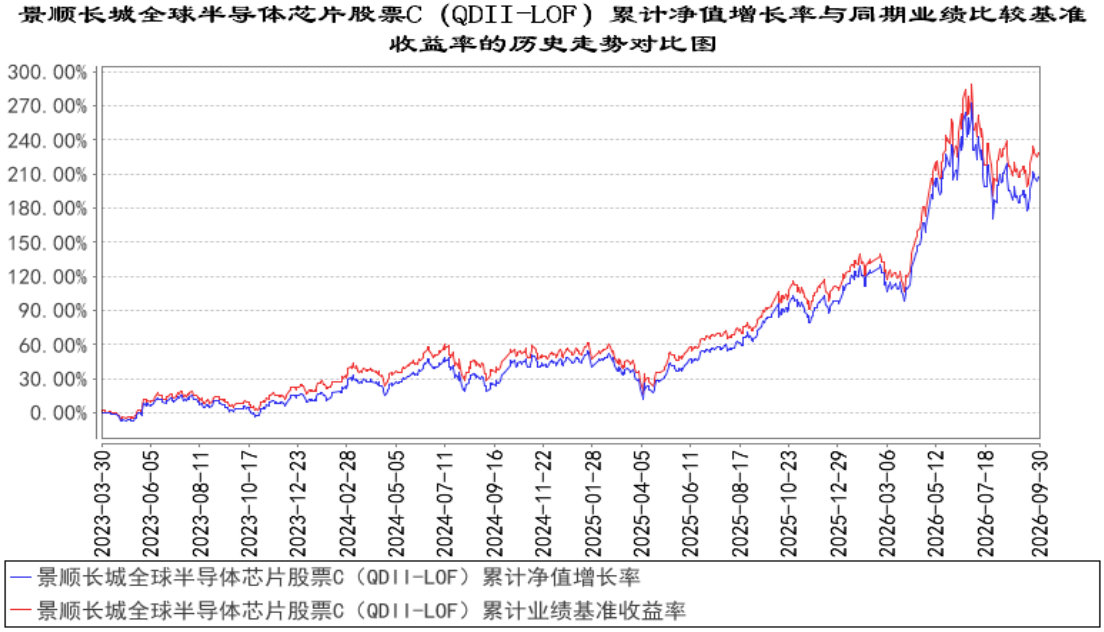
景顺长城全球半导体芯片股票 C（QDII-LOF）

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-17.82%	2.67%	-16.27%	2.51%	-1.55%	0.16%
过去六个月	49.44%	2.83%	51.16%	2.75%	-1.72%	0.08%
过去一年	64.50%	2.43%	67.15%	2.41%	-2.65%	0.02%
过去三年	194.96%	2.01%	201.93%	2.04%	-6.97%	-0.03%
自基金合同生效起至今	206.17%	1.93%	226.12%	1.95%	-19.95%	-0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较





注：本基金的投资组合比例为：本基金投资于 ETF 的比例不低于本基金资产的 80%；投资于境外资产的比例不低于本基金资产的 20%；投资于境内资产的比例不低于本基金资产的 20%；投资于权益类资产（包括股票、股票型基金）的比例不低于本基金资产的 80%；投资于本基金界定的半导体芯片产业主题的权益类资产（包括股票、股票型基金）的比例不低于本基金非现金资产部分的 80%。每个交易日日终在扣除应缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的建仓期为自 2023 年 3 月 30 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。自 2026 年 6 月 1 日起，本基金基准由“费城半导体指

数收益率 (PHLX Semiconductor Sector Index) (使用估值汇率调整)*75%+中证芯片产业指数收益率*15%+人民币活期存款利率(税后)*10%”调整为“费城半导体指数收益率 (PHLX Semiconductor Sector Index)*70%+中证芯片产业指数收益率*20%+人民币活期存款基准利率*10%”。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
金璜	本基金的基金经理	2024 年 1 月 19 日	-	10 年	工学硕士，CFA。曾任美国 AltfestPersonalWealthManagement（艾福斯特个人财富管理）投资部量化研究员，Morgan Stanley（美国摩根士丹利）风险管理部信用风险分析员。2018 年 7 月加入本公司，历任风险管理部经理、ETF 与创新投资部研究员、ETF 与创新投资部基金经理助理，自 2023 年 9 月起担任 ETF 与创新投资部基金经理。具有 10 年证券、基金行业从业经验。
汪洋	本基金的基金经理	2023 年 6 月 30 日	2026 年 9 月 17 日	18 年	理学硕士。曾任美国 KeyBank 利率衍生品部首席数量分析师，华泰联合证券股份有限公司金融工程部高级研究员，华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部基金经理助理，汇添富基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理，博时基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理兼基金经理。2021 年 10 月加入本公司，担任 ETF 与创新投资部总经理，自 2022 年 5 月起担任 ETF 与创新投资部基金经理，现任公司总经理助理、ETF 与创新投资部总经理、基金经理。具有 18 年证券、基金行业从业经验。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为公司决定且公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”及“离任日期”指根据公司决定且公告的聘任、解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

无。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

本季度在美联储加息预期上升、前期获利盘持续止盈、全球资本市场再平衡等因素的制约下，美股半导体呈现震荡下跌的态势。主要海外市场指数中，恒生指数(7.57%)>纳斯达克科技市值加权(5.66%)>标普 500(2.03%)>英国富时 100(1.04%)>纳斯达克 100(0.44%)>道琼斯工业平均(-2.70%)>恒生科技(-4.88%)>罗素 2000 指数(-7.52%)>费城半导体指数(-11.36%)。

本季度最近一次议息会议中，美联储决定加息 25 个基点，将联邦基金利率目标区间上调至 3.75%－4.00%，自 2023 年 7 月以来首次加息，符合市场对通胀控制的预期。本次会议中， 2026

年核心 PCE 通胀预期上修至 3.4%，整体 PCE 上修至 3.7%，GDP 增长预期小幅上调至 2.3%，2026 年失业率预期下修至 4.1%。决议公布后，市场倾向于将此次加息定性为 “风险管理式”或“预防式”调整，而非新一轮激进紧缩周期的开端，美国经济具备承受进一步紧缩的韧性。展望未来，全球宏观流动性有望继续保持相对宽松的环境，持续为市场提供较为充足的流动性并为美股估值释放压力。盈利端来看，美股半导体依然保持较为强劲的增长预期，根据彭博的预测，费城半导体指数整体上在未来两年的每股收益增长率分别为 39.1%、21.8%。

随着人工智能的投资价值从早期的 AI 基础设施投资转向确定性更高的应用场景落地，半导体行业有望延续之前的高景气度，并在投资收益上体现行业的高成长性。境外投资作为国内居民资产配置必不可少的一环，建议保持对海外科技类投资产品的关注。

本基金在严格控制组合风险与保持资产流动性的基础上，主要投资于全球范围内半导体芯片产业主题相关的公募基金的基金份额和相关上市公司，力争实现基金资产的长期稳健增值。在报告期内，本基金结合申购赎回情况、相关标的与基准指数的相关性情况等定期或不定期调整投资组合，实现对全球半导体芯片产业的有效风险暴露。

本报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为-17.73%，业绩比较基准收益率为-16.27%。

本报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为-17.82%，业绩比较基准收益率为-16.27%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：普通股	-	-
	优先股	-	-
	存托凭证	-	-
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	885,962,181.53	93.42
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-

	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	62,306,475.61	6.57
8	其他资产	69,755.46	0.01
9	合计	948,338,412.60	100.00

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）

1	Invesco Dynamic Semiconductors	股票型	交易型开放式(ETF)	Invesco Capital Management LLC	175,012,631.99	18.51
2	VanEck Semiconductor ETF	股票型	交易型开放式(ETF)	Van Eck Associates Corporation	171,724,864.91	18.17
3	Invesco PHLX Semiconductor ETF	股票型	交易型开放式(ETF)	Invesco Capital Management LLC	171,149,065.04	18.11
4	iShares Semiconductor ETF	股票型	交易型开放式(ETF)	BlackRock Fund Advisors	170,650,334.39	18.05
5	景顺长城中证芯片产业 ETF	股票型	交易型开放式(ETF)	景顺长城基金管理有限公司	62,788,694.70	6.64
6	华夏国证半导体芯片 ETF	股票型	交易型开放式(ETF)	华夏基金管理有限公司	62,626,648.50	6.63
7	国泰 CES 半导体芯片行业 ETF	股票型	交易型开放式(ETF)	国泰基金管理有限公司	62,276,557.20	6.59
8	Global X Semiconductor ETF/Jap	股票型	交易型开放式(ETF)	Global X Japan Co Ltd	9,733,384.80	1.03

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	69,755.46
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-

4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	69,755.46

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	景顺长城全球半导体芯片股票 A（QDII-LOF）	景顺长城全球半导体芯片股票 C（QDII-LOF）
报告期期初基金份额总额	239,211,983.86	82,806,748.09
报告期期间基金总申购份额	-	-
减：报告期期间基金总赎回份额	6,005,047.83	10,692,145.30
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	233,206,936.03	72,114,602.79

注：1.申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

2.本基金份额变动含人民币份额及美元现汇份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）募集注册的文件；

2、《景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》；

3、《景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）招募说明书》；

4、《景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

9.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司

2026 年 10 月 27 日